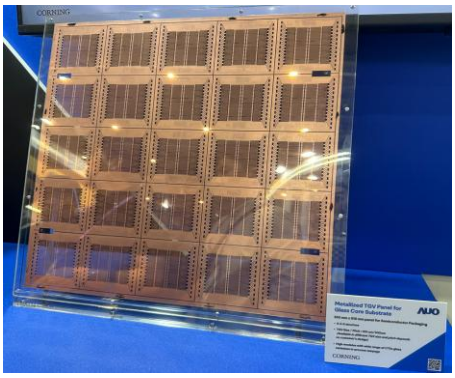
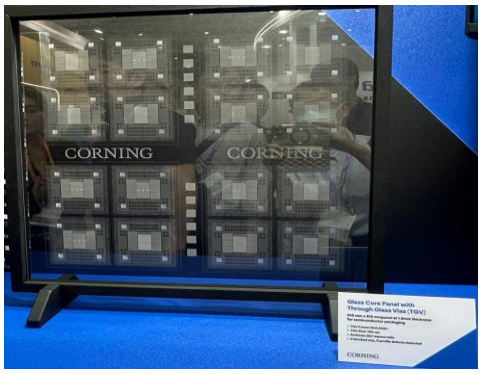
20260903- Semicon Taiwan 2026 摘要

No.	公司	說明	照片
1	TGV Panel	康寧展示半導體封裝的大尺寸 510x515 mm 金屬化玻璃穿孔（TGV）面板。採用 0-2-0 結構設計，TGV 尺寸與間距約 100 um / 300 um。其高剛性與廣泛的熱膨脹係數（CTEs）玻璃特性，能有效降低製程中的翹曲現象。	
2	Glass Core Panel	1.9mm 厚玻璃 TGV 面板。該面板有超過 840,000 個高密度 TGV 孔數，孔徑約 100 um，20:1 的深寬比。檢測結果顯示 0 阻塞孔與 0 缺陷的品質，凸顯玻璃基板在高階封裝的優越性。	
3	玻璃基板圓轉方比較	由工研院展示玻璃基板在「圓形晶圓」與「方形面板」形式上的比較與實體樣品。圖中 12 吋晶圓只能做出 4 片完整晶片，但方形面板 310mm*310mm 可以做出 9 片相同尺寸的晶片，有效提升晶圓片的利用率，並且能大幅節省成本。	

本項研究報告僅提供本公司會員參酌，且純粹屬於研究性質，並不保證報告內容的完整性與精確性，亦完全無意影響客戶買賣股票的任何投資決定。報告中的各項意見與預測，是得自於本公司信任為可靠的來源，受到特定的判斷日期之時效性限制，若嗣後有任何變動，本公司不做預告，也不會主動更新。投資人做任何決策時，必須自行謹慎評估相關風險，並就投資的結果自行負責。本研究報告的著作權為華南投顧所有，嚴禁抄襲、引用、對外傳送或轉載。

4	玻璃基板先進封裝結構-AGC	GC（旭硝子）展示次世代先進封裝（AGC）的 3D 立體模型，結合玻璃核心（Glass Core）、玻璃中介層（Glass Interposer）、盲腔（Blind Cavity）、xPU、HBM 以及高分子光波導（Polymer Optical Waveguide），呈現光電共封裝與玻璃基板結合的架構。	
5	TGV 玻璃基板金屬化與盲孔架構-AGC	AGC 的 TGV 玻璃基板應用成果，左側為具備金屬化製程的 TGV 玻璃基板，右側則為具備盲腔（Blind Cavity）結構的玻璃樣品。主要展示其在玻璃微孔加工、填孔導電與精密局部挖空技術上的領先製造實力。	
6	先進封裝架構-LG Chem	LG Chem 展出針對 AI 半導體封裝與次世代載板的解決方案模型。左側為適用於 AI 半導體的封裝方案，右側則為結合 Glass Interposer 與 Glass Core Solution 的次世代基板方案，透過創新的材料與結構設計，以滿足高效能運算的需求。	

本項研究報告僅提供本公司會員參酌，且純粹屬於研究性質，並不保證報告內容的完整性與精確性，亦完全無意影響客戶買賣股票的任何投資決定。報告中的各項意見與預測，是得自於本公司信任為可靠的來源，受到特定的判斷日期之時效性限制，若嗣後有任何變動，本公司不做預告，也不會主動更新。投資人做任何決策時，必須自行謹慎評估相關風險，並就投資的結果自行負責。本研究報告的著作權為華南投顧所有，嚴禁抄襲、引用、對外傳送或轉載。

本資料之內容，本公司已力求其正確性，惟純屬研究性質，投資人應審慎考量投資風險，本公司不負任何法律責任。本圖文非經同意請勿轉載，版權所有，翻印必究。